

窒化硼素(BN)焼結体

特徴

- 短納期対応(1.5ヶ月程度)
- 焼結体製造から加工まで一貫体制
- 数個単位から量産まで対応可能
- BN複合材取り扱いあり

用途

- セラミック基板焼成用セッター・匣鉢
- 各種絶縁部品

サイズ(材料)

500角×250mmt

700x400角x100mmt

	BN99	BN99.7
純度	≥99%	≥99.7%
密度	2.0g/cm ³	1.6g/cm ³



高純度SiCパウダー

概要

- SiCは耐食性や耐熱性に優れた半導電材料です。純度、粒径、結晶系の異なるラインアップからご用途に応じたグレードを提案いたします。

特徴

- 高純度 99.999%~
- 粒径 サブミクロン~数mm
- 低窒素含有量
- チャイナフリー

用途

- SiCウエハ 昇華法原料
- 半導体製造装置向け セラミックス

